



# 高科技產業之專利布局與策略聯盟



楊千旻\*

## 壹、前言

現今的高科技產業中策略聯盟已漸漸成爲各公司熱門的專利布局手段。最近著名的策略聯盟如鴻海與日本夏普合作，期望以此關係打入LCD市場並爭取到未來蘋果電腦的iTV的訂單<sup>1</sup>，而半導體產業中晶圓代工廠龍頭台積電，也擁有眾多的策略合作夥伴，此聯盟不僅關係到各公司的專利布局，甚而使合作夥伴擁有其他商業的附加價值，例如行銷管道與公司商譽等。然不可忽視者，在決定策略聯盟的同時，許多背景因素扮演著成敗的關鍵，包括產業之商業模式，其往往影響一個產業的發展型態甚至主導各公司間的發展目標。另觀目前專利訴訟趨勢，各公司的競爭對手與市場都趨於國際化，專利訴訟也搭上了全球化的風潮。因此，當前的科技公司在考慮商業模式時，還必須重新評估國際專利訴訟的風險。基於上述兩個因素，許多公司在近幾年一改消極累積專利組合的策略，反而積極尋求策略聯盟，以透過這樣的合作方式來達到專利布局的效果。本文欲先介紹半導體產業中商業模式的變化導致於高科技產業中策略聯盟的需求增加，第二部分則介紹目前策略聯盟的型式與重

\* 國立清華大學科技法律研究所助理教授。作者在此特別感謝國立交通大學電子工程學系楊家驥教授的寶貴意見。

<sup>1</sup> Digi Times, [http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnIID=&id=0000277415\\_S305NQZC0XDX7I6GGNHSW](http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnIID=&id=0000277415_S305NQZC0XDX7I6GGNHSW) (last visited July 5, 2012).

要性，第三部分深入探討不同的專利布局方法以及使用不同策略聯盟型式之適當性，最後綜合評析透過策略聯盟的專利布局可能會遇到的隱憂，包括策略聯盟下的專利布局是否可以解決國際專利訴訟之趨勢，以及策略聯盟夥伴由合作關係演變成競爭對手等問題。

## 貳、半導體產業商業模式

### 一、整合元件大廠（Integrated Device Manufacturer, IDM）的垂直整合

半導體產業的商業模式持續在演化，此因素影響世界各國科技公司之專利策略，也成為各公司的重要發展指標。半導體產業初期，普遍的商業模式為整合元件大廠，公司結構包括半導體產程中的IC設計、製造、測試到封裝等各部門，此類型的公司大多為財力雄厚的大型科技公司，部門之間以垂直緊密的方式分布，這也就是所謂的垂直整合模式。最具代表性的公司為Intel，而韓國三星也是標準的IDM商業模式，其在近年儼然成為各半導體公司可畏的競爭對手。由於IDM公司內部結構分明，部門之間聯繫緊密，技術發展具有整合性，智慧財產權自由流通，交易成本低，在管理方面公司集中擁有並且掌控所有在各製程階段的智慧財產權，特別是專利與know-how；產品製造過程中，技術相容性問題也相對較低，產品上市時間迅速且穩定，因此在競爭上擁有相對優勢<sup>2</sup>。

### 二、專業分工的水平整合

然而，在80年代後，掀起一股新的商業模式，半導體產業公司不再以擁有晶圓

---

<sup>2</sup> GEORGE S. HURTARTE, EVERT A. WOLSHEIMER & LISA M. TAFOYA, UNDERSTANDING FABLESS IC TECHNOLOGY 8, 139 (2007), p. 8: “The IDMs have total ownership and control of all the required resources for semiconductor manufacturing...”; p. 139: “Many of the most innovative products stem from fabless companies. Even though these organizations do not have direct control over their supply chain, they are expected to deliver products that meet the same Q&R standards as companies that own and manage their own fabrication facilities (IDMs).”

廠為先決要件，此發展歸功於專門代工製造晶圓的公司崛起，到目前為止已經成為全世界第三大半導體公司<sup>3</sup>的台積電即為首要代表。基於此市場結構之改變下的推波助瀾，致力於IC設計的公司如雨後春筍般發展，造就了半導體產業新的商業模式。受惠IC設計公司獨立發展下，其他獨立的晶圓廠和封裝測試公司也相繼成立，尤其前者總攬製造全世界半導體的產能，亦致力於發展成有能力替多家IC設計公司甚而是IDM等公司製造晶片的晶圓廠。半導體產業垂直整合的結構崩解，成為水平分布的情形，彷彿IDM公司的各部門紛紛獨立成為公司。半導體產業鏈中每個層級的公司數量增加，形成各自發展、百家爭鳴的情形，於美國稱之為西部大荒（wild west）。然而，水平分布的商業模式下，IC設計公司雖然擁有先進的技術，卻無法有效率地控制產品的製造與封裝，與晶圓廠的溝通過程，元組件相容性問題的排除等，導致於時間與品質控管皆需要投入大量的資源，成本相對提高。這樣的商業模式下雖然允許IC設計公司自由發展，然而在市場競爭力上卻缺乏和IDM抗衡的能力。在這樣的背景之下，各個半導體公司開始思考如何整合以達到IDM般的製造效率並解決相容性問題。

### 三、專業分工潮流繼續發展與策略聯盟的成立

近幾年各公司開始成立各式的策略聯盟，希望透過這樣的方式來達到類似IDM公司的垂直整合。值得一提的是，近年來IDM大廠紛紛為了減少建立晶圓廠的成本，許多歐美日等IDM公司在維持其龐大的規模之餘，持續進行垂直專業分工的解體，開始強調公司部門中的專業，並將部分部門之專業以委外方式進行，以求降低製造成本。最近的例子如日本半導體大廠Toshiba宣布於2011年擴大先進製程委外代工，包括台灣的台積電、南韓的三星電子和新加坡的全球晶圓都成為合作夥伴，也就是所謂的「輕晶圓策略」（fab-lite），將晶圓廠的設備與投資漸漸減輕，改由委外的方式，同時更開始積極尋找台灣的零件和材料供應商。

在這樣的背景下，半導體產業中專業分工與策略聯盟的潮流，已經推動各公司發展的方向，亦即，增強產業鏈間的合作才可以提升競爭力。然而，有學者提醒在形成策略聯盟時，需要留意是否因為策略聯盟而造成獨大的情況，這樣反而會使市

<sup>3</sup> <http://news.chinatimes.com/tech/171706/122012051600389.html> (last visited July 19, 2012).

場失去競爭而將導致科技發展的延緩。即便如此，策略聯盟的形成仍然持續發展中。SEMI台灣暨東南亞區總裁曹世綸指出，台灣的半導體產業供應鏈完整且製造技術和支援能力領先全球，成為各國半導體製造大廠委外製造和技術合作的最佳選擇<sup>4</sup>。因此，不僅是國外公司在思考成立策略聯盟的需求，台灣的供應鏈廠商也應該積極思考利用其產業鏈集中化的優勢，來增加自己與國外產業的競爭力。

此策略聯盟的形成趨勢不專獨於半導體產業，包括各消費者電子產品大廠以及面板等產業也都面臨類似的問題。因此本篇文章並不侷限於討論半導體產業，而是綜合討論相關的電子科技業之發展，來說明策略聯盟中的專利布局問題。

## 參、策略聯盟

### 一、策略聯盟之定義

研究顯示採取策略聯盟的公司大多可以提高雙方的盈收<sup>5</sup>。尤其如果聯盟的關係是採取同性質的部門間互相合作，產生經濟規模，則此部門的獲利率通常會提高。然亦有學者提出相反的意見，認為最好的策略聯盟在於補足對方所沒有的技術，若是互補的關係，則策略聯盟成功的機會較大。可見在學術上策略聯盟應該以垂直整合或水平整合並沒有一致的見解。策略聯盟的定義分歧，最廣義的為「任何公司同意與另一公司展開某種合作關係，以達到雙方互利的結果<sup>6</sup>」。在這樣的定義下，智慧財產權中的交互授權契約、專利聯盟、入股、合資或併購等都將包括在內。

於法律的用語上，學者通常對於策略聯盟之定義並不包括取得公司所有權的情形<sup>7</sup>，如上述後三者：入股、合資或併購的情況。這是因為由法律的角度觀之，有無取得公司所有權或經營權，在法律上之權利義務南轅北轍。此理論基礎重於區分「合併」與「聯盟」在公司價值體系中之核心活動的整合與重組考量所產生的不同

---

<sup>4</sup> [http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnId=13&id=0000249200\\_ZTC358FOLQZY18127XUEU&ct=1](http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnId=13&id=0000249200_ZTC358FOLQZY18127XUEU&ct=1) (last visited July 19, 2012).

<sup>5</sup> KOEN HEIMERIKS, DEVELOPING ALLIANCE CAPABILITIES 12-13 (2008).

<sup>6</sup> Jordan D. Lewis著，陳俞君、楊素真譯，透視策略聯盟，1995年，10頁。

<sup>7</sup> Cyrus Freidheim著，譚天譯，策略聯盟，2000年，27-31頁。

效果。申言之，「合併」的考量多集中於將雙方核心技術整合，並透過取得公司的所有權或經營權，以達到完整布局的效果；相反的，「聯盟」則因為並沒有取得所有權的關係，而對於布局的主控權較低，其影響對於公司之布局則相對有限。於本文中，由於探討的主題為專利布局，且不論是否取得公司所有權或經營權，皆有可能達成專利布局的目的，因此將採取最廣義的解釋以進行較全面之討論。

## 二、策略聯盟對高科技產業之重要性

### (一)經濟規模的影響

策略聯盟的重要性已成為高科技產業中公司間重要的競爭手段。對於策略聯盟有深入研究的學者傅瑞德漢解釋策略聯盟之重要性在於成立的經濟規模足以使此聯盟的公司獲致強化競爭力的效果<sup>8</sup>。傅瑞德漢所稱的聯盟較為極端，是指集中一切資源於一個主要的領域，重組整個工業，進行全球性規模的擴充，其中為了避免讓步妥協，往往成立關係企業，以成就「萬億金元企業」。業界透過策略聯盟的方式來擴大企業規模。傅瑞德漢相信唯有透過經濟規模才能得到市場競爭上的優勢。他的評論受到嚴重的抨擊，認為是在鼓吹企業間創造巨型企業怪物，讓市場呈現不自由競爭，以少數廠商成為獨斷的現象。此批評論點亦符合現今公平交易法中所管制的行為。然而，其提出的經濟效益，也就是經濟規模下產業間可以互利的效果，目前已被許多高科技產業所採納。因此，策略聯盟的主要目的為創造經濟規模，以幫助企業降低成本，提高競爭力。半導體產業於再整合商業模式下，如何擴大規模以達到規模經濟，整合所有其需要的資源使其在市場中成為強而有力的競爭者，成為當務之急。

以策略聯盟的整合來達到經濟規模之目的，實務上大多是指透過產業鏈中垂直供應商之間的合作，例如這次鬧得沸沸揚揚的鴻海入股夏普一事，暫且不論促成策略聯盟的背後契機，然而從技術與商業考量來看，鴻海整合了夏普的面板技術與鴻海的組裝能力，以此達到經濟規模，並且降低製造成本，推出具有競爭力的產品。有時策略聯盟除了進行垂直整合之外，有時也因為雙方有共同客戶而進行水平的整

---

<sup>8</sup> Cyrus Freidheim著，譚天譯，同前註，103頁。



合。由於蘋果電腦為鴻海與夏普的共同客戶，所以此經濟規模的效益也可以幫助到雙方的共同客戶。有趣的是，半導體產業龍頭台積電的商業模式並非以垂直整合為目的，其專精於發展晶圓技術，因為垂直整合將導致於其發展型態相似於IDM公司的模式，進而成為客戶的競爭對手。此商業模式避免了本文後段討論的問題，也就是如何應對合作夥伴成為競爭對手的情形。台積電也以此商業模式為傲，認為其為致勝關鍵。不過不可否認的，在近幾年台積電也開始與IDM公司成立策略聯盟，例如世界大廠Intel與瑞薩，也陸續與台積電進行製造流程的整合。

## (二)專利布局為共同發展目標

策略聯盟成功的先決條件在於首先成立公司之間共同發展目標，此目標必須靠彼此的優勢來設定，並依雙方的貢獻來分享雙方共創的利潤，通常若是互補的關係，則成功機率大。因此，在高科技產業中的產業鏈裡，若公司間有互補的作用，則成立某種策略聯盟將有助於其發展。共同的目標是雙方形成有效長久的聯盟關係之重要關鍵。若無法找出此共同目標，則聯盟的穩定性相對低，共同目標不易達到。

在半導體產業中，聯盟的目的主要集中於共同設計與共同開發，此不僅可以縮短設計或研發的時間，並且確定產品品質與技術的穩定。而製造時間的長短也影響到科技公司間之競爭優勢，產品品質則關係到產品銷路與公司獲利，兩者對於半導體產業的公司來說皆為重要的聯盟目的與結果。另外，成立聯盟的因素即提供共同的客戶更好的產品與服務。例如台積電和許多EDA公司成立合作聯盟，以進而提高其共同客戶IC設計的方便，並同時確保IC設計的品質。

然而，在高科技產業中往往忽視了一個重要的共同目的，即如何有效的透過策略聯盟之方式以達到專利布局的目的。由於技術日異月新，科技產品市場之脈動千變萬化，技術快速整合的需求亦與日俱增。在面臨如此快速變化的產業環境，累積性科技的本質導致於各公司展開專利組合的競賽<sup>9</sup>，目前已經沒有任何公司可以獨立生產產品，專利反而成為技術進步的絆腳石。詳言之，專利制度本來是以促進技術

---

<sup>9</sup> Browyn H. Hall & Rosemarie Ham Ziedonis, *The Patent Paradox Revisited: An Empirical Study of Patenting in the U.S. Semiconductor Industry, 1979-1995*, 32(1) RAND JOURNAL OF ECONOMICS 101-28 (2001).

發展的主要誘因，然而不可否認的，在高科技產業中，專利的排他性往往阻礙了技術合作的機會，反而增加產業的困難與成本。因此，為了解決這樣技術合作困難，公司大多透過交互授權等策略聯盟之成立來完成專利布局。除了造成交易成本提高之外，專利亦成爲阻擋競爭對手產品進入市場的致命武器。由目前各大科技公司操作專利訴訟的情況觀之，專利訴訟已成爲延緩競爭對手產品進入市場的手段。因此，如果可以透過策略聯盟得到所需的專利技術，一來可以避免因爲科技累積性質而遭到侵權的訴訟，二來也可以透過公司間的合作，增加自己面對專利訴訟的籌碼。高科技產業公司不僅在技術上需要面對技術合作時專利所造成的消極效益，亦需要解決競爭對手行使專利權時所產生的強大排他權之積極效益。因此，在選擇專利聯盟時，企業間已經不可忽略專利布局的重要性。

### 三、整合式與非整合式策略聯盟

上述的策略聯盟之定義大多以商業考量爲主，其爲廣義的概念。然由專利布局的角度觀之，不論是否取得公司所有權，不同合作關係皆可達到專利布局的目的。爲了本篇文章的討論完整性起見，此處的策略聯盟並不排除取得所有權的形式，而將針對任何合作方式，這也就是經濟學者所稱的整合（Integrated）或非整合（Non-integrated）的策略聯盟形式<sup>10</sup>。整合式策略聯盟是指兩間公司的整合，大多以取得經營權或公司所有權的方式，例如：公司的入股、併購、合資成立新公司等皆包括在內；而非整合形式則是指不需要取得公司經營權的合作方式，包括引薦、授權、簽署契約合作等。本文將基於這兩種不同的形式來探討專利布局。通常在考慮是否採取整合式策略聯盟時，下列三點爲高科技公司所必須思考的：

#### （一）交易成本考量

Teece教授主張公司在判斷策略聯盟形式時，首先必須考量此策略聯盟的交易成本<sup>11</sup>。倘若交易成本高於入股或併購的開銷，則公司應該採取整合式策略聯盟才符合經濟效益；反之，則應採取非整合式。於高科技產業的專業分工商業模式下，原

<sup>10</sup> DEEPAK SOMAYA & DAVID TEECE, THE TECHNOLOGY TRANSFER AND LICENSING OF KNOW-HOW AND INTELLECTUAL PROPERTY 123-45 (2008).

<sup>11</sup> *Id.* at 126.

本分工專精的企業紛紛尋求再整合，而其交易成本往往取決於種種因素，包括雙方公司的技術水準，技術本身的價值與其他法律文件與談判之成本等。因此，在評估整合式或非整合式時，交易成本為首要考量因素。

## (二)專利組合中的know-how多寡

由智慧財產權之保護觀之，若公司之專利組合（Patent Portfolio）包含的技術關係到know-how的部分較少，則因為技術轉移的困難度不高，相對的交易成本較低，且潛在溢出的智慧財產權之機率較低，因此公司間並不需要以取得公司所有權來保障其利益與智財，因此建議採取非整合式即可；相反的，若欲合作之技術是屬於高階的技術，或是專利技術中包含大量的know-how，則建議公司以整合式的策略聯盟為主。

## (三)設備成本

另外需要考量的因素還包括搭配技術所需要的設備。雖然設備成本應該放入交易成本中考量，但是在高科技產業中，許多設備價值匪淺，例如在半導體產業中的晶圓廠，則因為建構成本相當高，因此單獨討論之。建造晶圓廠的成本由早期的90奈米之20億美金，增加到現在最新的28奈米之70億美金。這樣天文數字的成本並不是每間高科技公司可以負擔的，即便是IDM也趨向分解其公司結構，不再建構自己的晶圓廠，而更加仰賴晶圓廠的服務。在這樣的經濟考量下，公司大多採取整合式的策略聯盟，例如目前世界第三大的晶圓廠<sup>12</sup>，全球晶圓（GlobalFoundries），其成立是由超微半導體（AMD）與杜拜的阿聯酋的先進技術投資公司（ATIC）合資，之後再合併新加坡的特許半導體公司（Chartered Semiconductor）而成立。這例子證明由於晶圓廠的高建構成本以及技術的複雜度，公司大多採取整合型策略聯盟，也就是確定自己對於公司的經營權或所有權之同時，也確保合作夥伴支出必要費用，並且共同承擔相關風險。

然而，有趣的是，今年由於台積電28奈米技術製成產量吃緊，許多公司無法確

---

<sup>12</sup> 此處GlobalFoundries為第三大晶圓廠，比較基礎以其他晶圓廠為主，與前述台積電為第三大半導體公司不同，因為其比較基礎包括IDM，晶圓廠與混合式半導體公司等之營收為主要比較對象。



定得到足夠的產能，造成半導體公司間的一片恐慌，公司間紛紛向台積電爭取優先製造的順序，此舉顯然在爭取先上市的契機，因為若被排在後面的順序，恐怕產品推出時，已經錯過商機。高通公司（Qualcomm）在這次的經驗之後，傳出開始考慮建造自己的晶圓廠，以確保產量能夠如期輸出。此可能代表半導體產業專業分工化商業模式的趨勢可能再次改變。

## 肆、專利布局

專利布局主要指運用專利權的積極價值與消極價值，使專利權人得到最大的利益。瑞典的工業管理與經濟學學者Ove Granstrand於1999年介紹了六種專利布局<sup>13</sup>的形式，其分析要點著重在經濟上考量與技術上的運用，奠定了專利布局的基本態樣，成為各大公司追求的手段。專利布局中的專利可以指單一專利的布局，專利組合或以整個公司為討論單位，而Granstrand教授之前提是以專利組合的布局出發。此前提剛好適用於討論半導體產業中的專利布局，因為大多數公司皆以專利組合的方式管理其專利，其介紹與分析如下：

### 一、特定阻卻性專利與迴避設計（Ad hoc blocking and inventing around）

#### （一）特定阻卻性專利

特定阻卻性專利與迴避設計之布局著重在於「特意」發明某些技術以「阻卻」他人使用，進而保護自己之科技與發明。特定阻卻性專利指的是專利權人為了保護自己的發明，而研發出來的一個專利，其意圖並非為了增進本身產品的品質或科技技術，而是專門為了阻卻競爭對手的專利。由於技術性不高，此舉最多只是為了拖延競爭對手深入瞭解新技術的內容，增加競爭對手進入市場的門檻，以拖延產品上

---

<sup>13</sup> OVE GRANSTRAND, THE ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY (1999)，其六種專利布局之中文翻譯部分參考洪永杰的微型可稀釋燃料電池應用專利探勘與創新設計系統之建構一文中的翻譯，<http://140.138.40.170/OptimalWeb/articlesystem/article/compressedfile/>，最後瀏覽日：2005年5月31日。

市的時間。迴避設計的重要性也在美國發展綠色專利時特別被強調<sup>14</sup>。此種技術大多由公司自己研發，針對某個技術而發明，因此不會爲了特定阻卻性專利與其他公司合作，策略聯盟的可能性低。而另一種方式爲迴避設計，即特意的發明技術以繞過對方技術來達到同樣的技術效果。其內容於下段與均等論詳細論述之。

## (二)迴避設計與均等論認定侵權的不確定性

相對於特定性阻卻專利是所謂的迴避設計。迴避設計是針對目標專利而爲具市場競爭力之不侵權產品之製造與行銷<sup>15</sup>，通常競爭對手在得知專利技術之後，以法院判斷專利侵權的標準來研究此專利，即全要件理論或均等論原則，並以此爲基礎刻意繞過此專利的設計，以確保自己不會侵害專利。然而，上述的研究過程當中，競爭對手必須建構一個假想的申請專利範圍，並取之與目標專利之申請專利範圍作爲比較，以確定是否已溢出（escape）目標專利之權利範疇。雖然迴避設計在可以達到不侵權之效果，但是由於均等論的假想申請範圍之抽象性，使競爭對手仍可能面對侵害專利之風險，不得不注意。迴避設計的技術，因爲參酌之前的技術，所以可能具有較佳的功能或較低的成本<sup>16</sup>。值得一提者，該等迴避之設計雖然相對目標專利有所進步，但是通常其技術並不是重要的專利技術，甚至若取之申請專利是否可以取得專利權都不確定。在高科技產業中，目前的科技爲累積性質，也就是說大多數的發明皆需要透過使用他人的專利，已經無法讓任何公司自己完成產品，因此透過迴避設計逃避該等發明的機會大，此亦爲專利界一直關注的議題。

同樣的，採取迴避設計的策略時，由於技術性相對較低，研發成本低，因此達成與目標專利相同功能的方式眾多，大多數的公司可以依靠自己的研發部門完成，而不需要花費太多的精力與成本，因此少有公司爲了特定性阻卻專利或迴避設計的

---

<sup>14</sup> Aspatore Special Report, The American Recovery and Reinvestment Act of 2009: An Immediate Look at the Legal, Governmental, and Economic Ramifications of President Obama's Stimulus Package (2009), "it is important for green companies and entrepreneurs to create and manage effective green patent portfolios and navigate around or benefit from the patents of others. This includes generating design-around strategies to avoid infringing third-party patents as well as learning from and improving upon others' patented technology."

<sup>15</sup> 羅炳榮，工業財產權論叢——專利侵害與迴避設計篇，2004年，176頁。

<sup>16</sup> 羅炳榮，同前註，176頁。

技術而與其他公司成立策略聯盟。

## 二、策略性專利布局（Strategic Patent Searching）

### （一）強大排他性專利包括先進技術與基礎技術

策略性專利布局為公司本身擁有一個強大排他性的專利。學者Granstrand此處所指的強大排他性的專利主要強調技術性高且關係到公司競爭力發展的專利<sup>17</sup>。通常競爭對手進行迴避設計困難度高，且所需要的成本亦高。各個公司都應該有此策略性專利以保持其在市場上的競爭力。此時公司除了應該著重於維持技術的先進性，還要將商業利益、法律訴訟策略與市場行銷等一同考慮進專利布局。例如，評估此策略性專利在市場上占有的優勢，在產業鏈中所扮演的主導性，以及將此專利技術商品化所需的成本等因素，綜合的來考量如何運用此策略性專利，來達到對於公司的最大利益<sup>18</sup>。策略性專利通常可以防止競爭對手進入市場，而專利權人可以選擇自己獨占而不授權給他人或者專屬授權給第三人。

然而，從近幾年的專利訴訟觀之，此種策略性專利布局已經不再侷限於技術性高的專利，而包括在科技領域中的基礎專利。通常，其技術性對於競爭對手來說並不困難，反而因為其為基礎技術，而使其他公司發展的產品必須建築在此基礎專利上。這種策略性專利在市場上也擁有強大的排他性。由於其技術性並不高，因此許多公司並不知道此基本技術已受到專利權的保護，而在推出產品後遭到專利權人的禁止。許多人質疑如果是基本的技術，是如何通過申請專利階段中的進步性要件。其實，這樣的基本專利都是公司在早年前就布局的專利，通常趁其他同業還沒有發展出符合市場需求的產品之前，就先將此技術申請專利。在申請的當下因為其他同業還沒發展此方面的技術，而具有進步性。此種專利有時經過十幾年後才完全發揮出作用。造成這樣發展的主要原因在於專利權的保護是二十年，但科技業的產品上市的淘汰週期很短，因此基礎專利很有可能在數年之後成為專利權人的利器。也因為有這樣的問題，許多學者呼籲發明專利的保護年限應該再為限縮，以符合世界科

<sup>17</sup> GRANSTRAND, *supra* note 13, at 218-22.

<sup>18</sup> 馮震宇，技術授權發展趨勢與新興授權模式，全國律師，2006年12月，10卷12期，42-43頁。

## (二)策略聯盟時需考慮動態能力與技術溢出 (Spill over)

由於策略性專利的強大排他性，具有市場競爭力，因此往往成爲有利的談判籌碼，給予專利權人較高的談判地位。由策略聯盟角度觀之，如上所述，專利權人可以選擇整合式或非整合式的策略聯盟方式。在整合式策略聯盟下，則往往因爲此強大的策略型專利而有機會取得目標公司的所有權或經營權。若公司不想進行策略聯盟，則此種策略性專利也可以成爲阻卻競爭對手之產品進入市場的利器。策略性專利在非整合式策略聯盟下，如交互授權關係中，使專利權人擁有優渥的談判籌碼，有利於幫助公司取得較有利的授權條件。

但須注意者，雖然擁有策略性專利，使此擁有獨特的資源的公司占有優勢，並且成爲策略聯盟的熱門合作對象，但是經濟學家呼籲策略聯盟的成功，不僅在於獨特的資源，還需要考慮到「動態能力」問題<sup>19</sup>。美國學者定義動態能力爲：公司整合、建立和重建內部和外部的能耐，去注意快速改變中的環境。動態能力反應一個組織的能力已達成新的和創新的競爭優勢，來自路徑依賴和市場地位<sup>20</sup>。支持動態能力論的學者認爲資源本身並不能創造與組合資源，相反的，需要有適應環境需求的能力才能創造出競爭優勢<sup>21</sup>。因此，倚賴策略性專利布局來進行策略聯盟時，通常不可只評估策略性專利的強大排他性，而忽略了此公司與技術對於市場環境變化的應變能力，也就是公司與技術的彈性 (flexibility)。

另外，由經濟學諾貝爾獎得主的寇斯 (Coase) 理論可以知道如果降低交易成本，則交易雙方越容易達到最有效率的合作關係，而不用依靠法律規範或契約規定，如此可以推斷出交易成本越低雙方合作的確定性越高。因此降低交易成本成爲促進策略聯盟效率性的主要考量因素。然而，任何交易都有交易成本的存在，因此

<sup>19</sup> 吳克，策略聯盟的兩難，2011年，115-120頁。

<sup>20</sup> D. J. Teece, G. Pisano & A. Shuew, *Dynamic Capabilities and Strategic Management*, 18(7) STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL 509-33 (1997).

<sup>21</sup> K. M. Eiscenhardt & J. A. Martin, *Dynamic Capabilities: What are they?*, 21 STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL, Issue10-11, 1105-21 (2000).

爲了增加合作效率，通常合作雙方都會往共同降低交易成本的目標爲目標<sup>22</sup>。在高科技產業中，交易成本大多取決於此專利所附屬的know-how數量。由於專利權所附屬的know-how越多，公司越容易擔心技術溢出的問題，抑或公司必須承擔提供教導被授權人瞭解並實施專利技術的服務契約，種種因素提高交易成本；由被授權人的角度來看，其學習成本提高，時間拖延，在簽訂契約時，也必須多增加法律上的契約規定，以保障自己得到策略性專利的目的。

交易成本的高低也會影響公司決定策略聯盟的方式。由於策略性專利對公司的價值高，且往往伴隨著許多的know-how，因此大多公司不願意透過非整合性的策略聯盟。以交互授權的方式移轉技術爲例，因爲在交互授權的過程中容易洩漏know-how而使公司失去許多競爭的優勢；或是聯盟夥伴因爲不瞭解know-how而無法完全使用授權來的技術等問題。故策略性專利所牽連策略聯盟方式大多傾向於以整合式的策略聯盟爲主。

### 三、地毯式（氾濫式）專利布局（Blanketing or Flooding Strategy）

#### （一）因應專利組合競賽之布局方法

地毯式專利布局顧名思義，就是透過地毯式的大規模布局，於某個領域的技術有系統的申請專利，造成當競爭對手嘗試進入市場時，因爲你已經布局的專利而阻止其進入市場，或者提高其進入市場的阻礙（entry-barrier）或成本。通常，地毯式的布局需要大量的專利，包括重要專利或垃圾專利。此布局方式成本高，但可提高專利權人於交互授權時的談判籌碼。如果無法有系統的申請專利，則稱爲氾濫式的專利布局。

地毯式專利布局的起源由美國學者討論現在科技的累積性特質<sup>23</sup>。於1980年代，各大半導體產業公司積極申請專利，卻沒有積極行使專利權，因此對於這樣矛盾的行爲展開調查，並希望找出公司申請專利的誘因。其結果發現，如果此科技產業的技術屬於累積性的技術，例如半導體產業與電子產品產業，則產業間則因爲科技累積性而常出現公司間互相挾持的狀況（mutual hold-up），也就是雙方公司互不

<sup>22</sup> Cyrus Freidheim著，譚天譯，註7書，27-32頁。

<sup>23</sup> SOMAYA & TEECE, *supra* note 10, at 101-05.



授權，導致雙方皆無法實施技術，科技發展延滯。公司爲了防止被挾持，因此開始累積自己的專利數量而建立起專利叢林（patent thicket），增加可以排除他人的專利權，以提高自己在談判授權的過程中之地位。又有學者發現，當大公司開始積極申請專利時，將會帶給競爭對手壓力，導致競爭對手也開始積極申請專利，而展開了一系列的專利組合競賽<sup>24</sup>。這樣的專利組合競賽影響引起許多學者的批評，認爲浪費社會資源並且阻礙科技進步。但是直到目前爲止，似乎沒有發現因爲科技業中專利組合的競爭而導致延滯科技的發展，相反的，科技仍然以飛快的速度在進步，科技公司仍然在大量的申請專利<sup>25</sup>。值得探討的是，科技公司之間開始成立大規模的聯盟關係，以此壯大自己的專利組合，提高自己在專利組合競賽中的優勢。例如生物科技公司與學界或非營利機構合作，成立大量的生物材料資料庫；或者是半導體產業中的共同研發計畫，以及消費者電子產品的專利聯盟等，可見業者找尋各種不同的合作方式來持續這場競賽。

地毯式專利布局遭到許多學者的批評，認爲許多公司花大量的資源於購買不重要的專利，反而沒有將資源花在研發新的產品之方向，阻礙科技的發展<sup>26</sup>。另外，美國最高法院之Kennedy法官於eBay案中即發現了地毯式專利布局中許多的小專利而衍生出在訴訟上的情形<sup>27</sup>：許多廠商爲了得到較好的授權談判地位，因此故意拖延提告時間，在被告不知情有侵權的狀況下，將其產品發展完成，並投入相當的投資與努力後，原告才在最後一刻提起訴訟。然而仔細觀之，原告提出的專利只是被告產品裡極小的一個元件，並非主要發明，但是卻可以享有相同的排他權，導致被告產品無法如期上市。因此已經有許多學者提出需要專利改革的聲浪，包括進步性要件的審核應更嚴謹與舉發的過程讓第三方參與等。

---

<sup>24</sup> S. Kortum & J. Lerner, *Stronger Protection or Technological Revolution: What is Behind the Recent Surge in Patenting?*, 48 CARNEGIE-ROCHESTER CONFERENCE SERIES ON PUBLIC POLICY 247-304 (1998).

<sup>25</sup> Jonathan M. Barnett, *Property as Process: How Innovation Markets Select Innovation Regimes*, 119 YALE L.J. 384 (2009).

<sup>26</sup> William E. Kovacic, *Intellectual Policy and Competition Policy*, 66 N.Y.U. ANN. SURV. AM. L. 421 (2011).

<sup>27</sup> eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. 547 U.S. 388 (2006).

## (二)整合型策略聯盟以面對專利訴訟

若要透過策略聯盟來達到地毯式專利布局，通常可以分為整合式策略聯盟與非整合式策略聯盟來討論。整合式策略聯盟通常在於取得專利的所有權，最大的優勢在於取得專利的訴訟權。許多公司透過大量購買第三人的專利，以期望提供反訴的力量，例如宏達電購買S3 Graphics的專利以期可以對抗蘋果的反訴。另外，目前各大公司皆進行地毯式專利布局競賽，以確實維護商譽、累積面對訴訟的武器和提高交互授權時的談判籌碼。然而，若購買的專利中沒有核心技術專利，其實對於談判或訴訟幫助皆不大。因此，在進行專利購買時，仍應該妥善評估所購專利的素質與購買之目的。

## (三)非整合型策略聯盟以取得不被控告的權利

由於地毯式專利布局的專利量眾多，如果沒有訴訟的考量，也可利用非整合式的策略聯盟來達成目的。非整合式的策略聯盟包括專利交互授權（cross-license），專利聯盟（patent pool）以及標準化技術專利等。交互授權就是公司雙方利用自己所擁有的專利組合來交換與另一公司的專利組合，通常可以省去或減少授權金之支出，以藉此擴大專利使用權，獲得設計自由，也就是所謂的取得不被控告的權利（right not to be sued）。專利聯盟則是指不同公司將自己的專利有條件釋出以達成授權與降低交易成本之雙重目的，此與專利交互授權不同處在於使用的公司通常仍然需要支付一定價格的授權金。專利交互授權與專利聯盟皆使公司取得不被控告的權利，大多為防禦的目的，但是沒有提起訴訟的資格。因此，在考慮是否採取整合式或非整合式策略聯盟時，應該先綜合評估公司本身專利組合的強度，以及在產業中面臨競爭者以其所布局之專利對公司本身提起訴訟的機率。

## 四、圍牆式專利布局（Fencing Strategy）

圍牆式專利布局是指運用某系列式的專利來阻止研究與開發（Research & Development, R&D）的發展，此布局方式之動機與地毯式專利布局類似，但是其目的性比地毯式專利布局清楚，不是大範圍的進行，而是指針對某一個特殊系列的發展而言。例如利用化學程式中的分子設計、其幾何圖形、溫度與氣壓等一系列的因

素來阻擋對方研發的方向<sup>28</sup>。通常如果有數個不同的技術可以達到相同的功能時，爲了防止競爭對手迴避設計，而採取圍牆式專利布局。由策略聯盟的角度觀之，圍牆式專利布局可以採取整合式或非整合式策略聯盟，其考量因素與地毯式專利布局類似，在此即不贅述。

## 五、包繞式專利布局（Surrounding Strategy）

### （一）應用專利來圍繞基礎專利以求交互授權

包繞式專利布局著重在針對一個重要基礎型專利，競爭對手組合起數個專利，包繞此基礎專利以阻卻其應用，癱瘓此基礎專利。申言之，通常基礎專利強大，有如上述的策略型專利，競爭對手雖然沒有此先進的技術，但是如果可以基於此基礎專利，研發出應用專利使技術產品化，並將所有可以應用此基礎技術的方式申請起專利，也就是應用專利（**application patent**），至使原本的基礎專利權人雖然擁有強大的專利權，卻因爲無法應用此專利技術而使其發展受到阻礙。相同的，取得應用專利的公司雖然擁有應用專利，卻因爲沒有取得基礎專利的「不被控告權」，因此也沒有應用的可能。雙方因此造成互相挾持（**mutual hold-up**）的局面。這是因爲專利權爲排他的權利，也就是原專利權人可以排除應用專利權人實施其專利，而同時應用專利權人可以排除原專利權人應用其專利。當初日本公司極具創造力，對於技術應用的敏銳度高，因此申請了許多應用專利，導致於美國許多基礎專利在面對商品化其技術時，遇到無法產品化的困難。當競爭對手有效的包圍原專利權後，即有足夠的力量要求原專利權人交互授權，以藉此達到布局的目的。須注意的是，在包圍式專利布局下，應用專利的專利權人需要有效的包圍住原專利才行，否則原專利權人若發展出其他的應用方式，則被挾持的機會降低，則應用專利權人無法取得交互授權的可能，反而造成自己必須單方向原專利權人要求授權的狀況，失去談判籌碼。

在策略聯盟之考量下，此種布局方式大多希望得到強迫原專利權人同意交互授權的結果，因此非整合式的策略聯盟已足。爲了達到有效的包圍，有些競爭對手也

---

<sup>28</sup> GRANSTRAND, *supra* note 13, at 218-22.

會聯合起來包圍基礎專利，不過這樣的聯盟也並不需以整合型策略聯盟為之，因為主要目的只是要強迫原專利權人釋出技術交互授權。

## 六、組合式專利布局

綜合運用上述的專利布局方法，以達到最大利益。其實大多數的公司都不會只單獨採取一種專利布局的方式，因此各個公司需要分別就自己的特殊需求來進行組成一個適切專利組合的綜合評估，以圖強化保護專利權與談判籌碼，並降低交易成本。

## 七、收費站策略（Toll gate strategy）

除了上述Granstrand教授提出的六種專利布局型態，國內學者馮震宇教授也介紹了另一個布局方法，稱為收費站策略（Toll gate strategy）<sup>29</sup>，主要特徵在於直接發展下一世代的技術，並透過嚴密的專利策略申請所有可能或相關改良技術，等到該次世代技術獲得產業接受時，此專利布局已允許此公司掌控整個產業的發展。最有名的例子即高通（Qualcomm）嚴密的布局取得第三代通訊技術（3G），導致現在從事3G的業者均需要向高通授權，類似使用高速公路所需繳交的通行費。採取此種策略者通常希望自己研發，且其技術相當先進，公司也必須擁有遠見，故成功並非易事。在策略聯盟方面，如果其他的公司沒有相同的先進技術與遠見，則合作的可能性較低。畢竟策略聯盟的成功倚賴雙方的共同目的，而此處的目的在於研發下一個未被大眾或產業接受的技術，因此要找到志同道合的夥伴並不容易。

## 伍、綜合評析

由上可知專利布局可以透過策略聯盟來完成。然而在現實社會中，策略聯盟對於全球專利訴訟的影響為何？若策略聯盟夥伴後來轉為競爭對手之問題該如何處理？本段針對這兩個議題分別提出綜合的分析：

---

<sup>29</sup> 馮震宇，鳥瞰21世紀智慧財產從創新研發到保護運用，2011年，52-57頁。

## 一、全球專利訴訟之危機

在高科技產業中，專利訴訟已經普遍成爲一個商業競爭手段，此風潮已經席捲全球，各國的科技公司皆人心惶惶。國際間專利訴訟興起，其主要因素爲高科技產業鏈中的各公司已經遍布歐、美與亞洲，因此競爭對手已經由國內廠商轉爲國際的廠商。另外，專利訴訟全球化的另一個原因在於專利地雷遍布世界不同的市場位置，所屬專利權人可利用所擁有之專利權中的進口權來禁止競爭對手的產品進入市場。爲了應付專利訴訟，在美國已有許多公司成立策略聯盟，以專利聯盟的方式釋出自己的專利，藉此取得其他公司的專利使用權，以降低專利訴訟的風險<sup>30</sup>。可見只爲了防禦訴訟之目的，已經有許多公司成立防禦性專利聯盟（Defensive Patent Aggregators）<sup>31</sup>。此專利聯盟之利益在於提供任何一個會員公司面對專利訴訟時，可透過此專利聯盟來取得專利以反訴原告或得到相關的專利授權，以避開專利侵權。許多公司稱此種策略聯盟爲替公司買專利訴訟保險。此專利聯盟雖然對於一般競爭對手有效，但是面對專利地雷卻沒有太大的效用，因爲專利地雷通常沒有生產產品，因此無法以反訴做威脅。由此可見，已經有許多公司開始思考以策略聯盟之方式來對抗專利訴訟，有些學者更相信公司加入此聯盟的主要目的就是增加自己在訴訟時的優勢，但是對於不用擔心專利訴訟的公司如世界銀行或某些基金會來說，其主要的目的是分享利益<sup>32</sup>。由於此專利聯盟還在發展中，其成效仍有待觀察。

目前面對專利訴訟時，實務上的方法多採取整合型策略聯盟爲主，以購買其他公司的專利權來達成反訴對方的目的。但是這多是在被告之後才積極尋求的方法。

各個公司在進行專利布局時，應該先將專利訴訟的風險考慮進去，釐清產品之核心基礎專利，並評估是否可以透過迴避設計來預防被告侵權。簡言之，若迴避設計之成本過高，則應該考慮發展策略性專利或圍牆式專利布局，並以整合式的策略聯盟來提前準備，因爲核心技術不宜與他人分享。若並非核心技術，則可以考慮地毯式的專利布局，並採取非整合型策略聯盟即可。至於包繞式策略聯盟目的在於取得基礎專利的交互授權，雖然無法像反訴的威嚇效果，但是如果可以阻止對方實施

<sup>30</sup> Allen W. Wang, *Rise of Patent Intermediaries*, 25 BERKELEY TECH. LAW JOURNAL 159 (2010).

<sup>31</sup> 最著名的例子是美國的RPX公司，由IBM、Cisco等大公司組成。

<sup>32</sup> Robin Feldman & Tom Ewing, *The Giants among Us*, STAN. TECH. L. REV. 1 (2012).



其基礎專利，則不失為降低訴訟方營業收入的方法之一，對於專利訴訟也可以稱為促進和解的動力。

## 二、合作夥伴轉變為競爭關係

### (一)技術溢出

透過策略聯盟進行專利布局時，必須瞭解合作夥伴未來業務之發展走向，並留意合作夥伴成為競爭對手的可能。研究指出策略聯盟失敗的首要原因在於選擇錯誤的合作夥伴，並且對整個合作關係過於樂觀<sup>33</sup>。因此，如果合作夥伴非常有可能成為未來的競爭對手，則合作方式宜採取整合型策略聯盟為宜。主要原因在於採取整合型策略聯盟時，可以降低重要技術流失的風險，也就是保護所謂的技術溢出。

透過整合型策略聯盟，公司間保持住對技術的控制權或所有權，因此，技術之溢出可以得到有效的控制。而透過非整合型策略聯盟，由於在合作關係的過程當中，雙方認諾者只僅限於原授權契約之內容，技術溢出的可能性大，對於保障智慧財產權並不全面。例如現今的蘋果與三星，原本為長期的合作夥伴，三星提供蘋果快閃記憶體等晶片，然而三星開始多方面發展，包括LCD與OLED等，其研發之智慧型手機銷售量更是躍昇為世界第一的成績，給予合作夥伴蘋果在iPhone市場上相當大的壓力，導致原本的垂直供應鏈的關係變成水平的競爭關係，並因此引發了蘋果對三星一連串的專利侵權訴訟。姑且不論三星智慧型手機之蓬勃發展是否可以歸功於替蘋果提供晶片時而取得之技術溢出，這樣的關係已不得不讓我們思考未來選擇策略聯盟夥伴時應考量的因素，甚至應該在合作初期先整理出專利組合中各專利的重要性。

### (二)公平交易法與專利申請範圍

若要求整合所有可能成為競爭對手的合作夥伴，在經濟上與法律上都顯不切實際。從經濟上來看，整合型策略聯盟往往牽涉高額的投資，並非一般公司可以輕易負擔，因此成效並不大。由法律面觀之，當與數個不同的合作夥伴進行整合型策略聯盟，則容易構成公平交易法中所謂的聯合行為或者形成壟斷，而導致反競爭的結

<sup>33</sup> Cyrus Freidheim著，譚天譯，註7書，172-175頁。

果。另外，有學者提出若欲促進以增進科技發展或商業利益的策略聯盟，可以由專利申請的撰寫開始。當撰寫專利申請專利範圍時，若過度擴大專利範圍，則容易造成技術成爲累積性質，因爲大的專利範圍容易包含到其它技術，而形成互相挾持的情況，因此如果可以在申請專利之初，合理縮小專利申請範圍（tailoring），減少相互挾持與跳脫累積性性質的本質，則可以使策略聯盟之目的專注於科技進步與商業利益的考量，而不是因爲技術相互挾持的原因而被迫成立策略聯盟<sup>34</sup>。但是促進科技發展往往是法律政策面的問題，並非產業界中公司的主要考量，因此大多公司仍會儘量擴大專利申請範圍以保障自己擁有挾持對方的專利，藉此保全自己的競爭力與談判能量。

許多時候若無法在合作初期清楚判斷出合作夥伴將來是否可能成爲競爭對手時，則在聯盟關係下，應該保護核心能力的技術，只分享一般性的技術設備，但是不輕易透漏核心製造技術或製造設備的要求<sup>35</sup>，以此確保聯盟關係中，既可以得到系統上的整合優勢，但是不失去維持競爭力的核心技術。

### （三）專利授權契約

在專利授權方面宜限定實施目的，以確保合作夥伴不會將你的技術使用在與你競爭的產品上。基於電子產品發展之快速，限定時間的專利授權也是保護技術的方法。若有共同研發之技術，其所有權歸屬也應該明定之，基於專利權共有的種種不便，例如專利申請與撤回等程序上依照專利法第12條之規定，需要專利權人共同爲之，則在實務上操作較爲繁瑣，尤其如果合作夥伴成爲競爭對手時，是否履行其共同義務並不確定，有時此權利亦成爲雙方在談判時的另一個談判籌碼。因此在設定所有權時應該避免專利權共有，而所有權應該以此技術所歸屬的基礎發明爲設定依據。而至於技術溢出的部分，由於其範圍較爲抽象且難界定，因此將是策略聯盟中較難處理的問題。如果公司在評估自己的技術屬於技術容易溢出的特質，則應該慎重考慮是否採取策略聯盟。

---

<sup>34</sup> Robert P. Merges & Richard R. Nelson, *On the Complex Economics of Patent Scope*, 90 C.L.R. 4 (1990).

<sup>35</sup> Jordan D. Lewis 著，陳俞君、楊素真譯，註6書，109-126頁。

## 陸、總 結

由本文首先介紹的半導體產業之商業模式的轉變，可知自80年代晶圓廠的出現，引發了垂直整合的IDM公司開始解體，走向專業分工趨勢，各種不同的科技公司如雨後春筍般發展出來。產業鏈由垂直轉為水平分散，技術開始分歧，高科技產業成為所謂的西部大荒的局面。專業分工出來的公司在技術整合與成本考量上，並無法與大廠IDM相比，引發了策略聯盟的需求。到最近五年，高科技產業間掀起了一陣國際性的專利訴訟戰爭，主要原因在於許多基本技術掌握於少數的公司手上，各公司在製造商品時常在不知情的狀況下，因產製技術上相重疊之產品而侵害到別的公司的專利。而此因素也促使公司間以策略聯盟的方式來因應。

有鑑於策略聯盟的需求增加，確保策略聯盟成功成為重要目標。策略聯盟成功的關鍵往往在於找到雙方共同的目標。在高科技產業中大多以共同研發為目標，但是卻忽略了專利布局的重要。由現在高科技產業中技術的累積性特質看來，專利已經成為阻擋技術整合與產品進入市場的利器，因此透過策略聯盟的專利布局不但可以促進技術整合，也可以避免產品被競爭對手排除。本文中的策略聯盟分為兩種型式，包括整合型策略聯盟與非整合型策略聯盟。前者主要是以取得公司所有權與控制權為主，包括入股、合併、合資與併購等；而後者則指非以取得公司所有權或控制權為目的的合作關係，包括交互授權或專利聯盟等。

專利布局的方式本文介紹了七種，其布局目的與方式皆有所不同。其中又以策略性專利布局、地毯式專利布局與圍繞式專利布局最具代表性。策略性專利布局中的專利已經不再專屬於技術先進的專利，而也包括了排他性強的基礎專利，在考慮是否以整合式策略聯盟時，應該將技術溢出的因素設為優先考量因素。在地毯式專利布局下，專利組合之競賽遭到學者與業界的批評，認為浪費社會資源，並且使許多技術性較低而對產業無實益的專利都被包含專利組合裡，失去專利法獎勵發明以促進技術進步之初衷。美國最高法院在eBay案中也批評了業界以技術性低的專利來排除競爭對手的產品，甚至故意等待競爭對手投入相當投資之後才提起訴訟，使其進退兩難，以增加談判籌碼與授權機會。在考慮是否以整合式策略聯盟來布局地毯式專利時，通常以是否須面對專利訴訟為考量，因為地毯式專利組合通常可以用來反訴，而反訴者需要是專利權的所有人，故此時整合性策略聯盟為必需。最後較特

別的為圍繞式專利布局，其主要目的以強迫對方交互授權，因此通常非整合型的策略聯盟即足。

最後，以專利布局為目的之策略聯盟在面對國際專利訴訟的效力為何？目前美國已有抵抗專利訴訟的策略聯盟，但是效果仍待觀察。因此實務上仍然採取整合型策略聯盟來對抗國際間的專利訴訟，其中策略性、地毯式與圍繞式專利布局皆可運用。而至於合作夥伴轉成競爭對手時，應該在聯盟成立之初就將此情形列入考慮因素，並妥善處理技術溢出、聯合行為以及專利授權之特別限制等規定來保全自己的技術。總之，透過策略聯盟來達到專利布局之目的已經是企業間不可忽略的考量因素。在這分分合合的轉變中，唯有仔細評估自己專利的價值與產業結構，並且找到正確的聯盟方式，靈活運用不同的專利布局方法，才能成為最後的贏家。